

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所用若干技術詞彙的解釋。因此，該等詞彙及其涵義未必與其標準業界涵義或用法一致。

「5G」	指	第五代無線通訊技術標準，旨在提供較前幾代移動網路更快的數據傳輸速度、更低的延遲，以及更廣泛的連線能力
「ABF」	指	味之素積層膜，是一種用於IC封裝載板的核心絕緣材料
「ADAS」	指	先進駕駛輔助系統
「AI」	指	人工智能
「ASIC」	指	特定應用積體電路，即專為特定用途設計並依據特定使用者需求及電子系統而製造的積體電路
「BT」	指	雙馬來酰亞胺三嗪樹脂，是一種用作IC封裝載板材料的聚合物
「複合年增長率」	指	複合年增長率，以期末價值除以期初價值，並將得出之商乘以一除以年期長度所計算的次方數，再減去一計算得出
「CMOS」	指	互補金屬氧化物半導體
「CoWoS」	指	晶圓級晶片封裝載板，一種用於超高性能運算應用的先進半導體封裝技術，例如人工智能(AI)及超級運算
「CPU」	指	中央處理器，一套複雜的電子電路，負責執行電腦的運行系統與應用程式
「CSP」	指	芯片級封裝，是一種IC封裝，其面積不大於晶片本身面積的1.2倍
「CSP載板」	指	採用打線接合方法進行CSP封裝的IC載板，不包括FCCSP載板
「CTE」	指	熱膨脹係數
「晶片」	指	一塊小型半導體材料塊，其上製有特定功能電路

技術詞彙表

「DRAM」	指	動態隨機存取存儲器，是一種隨機存取的半導體存儲器，將每一位數據存儲在一個存儲單元
「FCBGA」	指	倒裝芯片球柵陣列封裝，是一種高密度、高性能的半導體封裝技術，其中IC晶片被翻轉，並通過導電凸點直接焊接到載板上
「FCBGA載板」	指	用於FCBGA封裝的IC載板
「FCCSP」	指	倒裝芯片芯片級封裝，是一種將倒裝芯片鍵合技術與芯片級封裝形式相結合的先進半導體封裝技術
「FCCSP載板」	指	用於FCCSP封裝的IC載板
「FIB」	指	聚焦離子束，是一種採用電子束對樣品進行成像的先進製造及分析工具
「GDP」	指	國內生產總值
「建築面積」	指	建築面積
「GPU」	指	圖形處理單元，一種專為處理圖形處理與平行運算任務而設計的通用處理器
「I/O」	指	輸入／輸出，指通訊及信號或數據傳輸
「IC」	指	積體電路或「芯片」，是一種將多個電晶體和電子電路整合於一片硅片上的半導體元件
「IC載板」	指	一種由多層複合材料構成的專用平台，將裸芯片連接至印刷電路板，為芯片提供電氣連接、機械支撐及散熱路徑
「IC封裝」或「封裝」	指	將半導體芯片封裝於保護外殼內的過程，此舉有助於建立電氣連接並促進散熱
「物聯網」	指	物聯網，即由嵌入傳感器、軟件及其他技術，藉此透過互聯網與其他裝置及系統進行連接與數據交換
「IPD」	指	整合式被動元件

技術詞彙表

「IVR」	指	整合式電壓調節器
「LDI」	指	激光直接成像
「mSAP」	指	改良型半加成工藝，是製造超細銅電路線路的先進製造工法
「PCB」	指	印刷電路板的縮寫，一種由印刷導體層與電氣絕緣層交替堆疊而成的平板複合材料，通常透過導電孔相互連接；PCB提供平台，用以連接半導體及其他電子、光學或機械裝置，以形成電路或功能系統
「半固化膠片」	指	預浸材料，即由玻璃纖維與樹脂複合而成的材料
「RF」	指	射頻
「SiP」	指	系統級封裝，是一種將多個IC整合為單一模組的先進半導體封裝技術
「晶圓」	指	用於製造IC的半導體薄片
「平方米」	指	平方米